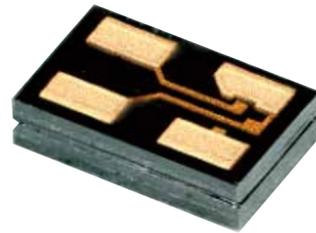


32.768kHz MEMS谐振器

通过使用MEMS技术，实现了传统晶体谐振器达不到的超小尺寸低ESR特性。



应用



规格

项目	规格
封装	0.95×0.6×0.30mm
工作温度	-40 ~ +85°C
频率公差 (+25°C)	±20ppm
频率稳定性 (-40/+85°C)	+10ppm/-150ppm
等效串联电阻 (ESR)	70k ohm Max.
驱动电频 (DL)	0.2μW Max.
频率老化率	±3ppm Max./Year

特点

小尺寸+内部集成负载电容=相较于1.2x 1.0传统晶体谐振器，节省60%布板空间。

- 低ESR→低功耗。
- 可用于回流焊、wire bonding和IC内部集成封装。
- 可以改善温度引起的频偏，特别是高温条件下的频移。

